

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2026-76

深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于为子公司融资提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述及进展情况

1、深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）于 2026 年 4 月 17 日、2026 年 5 月 11 日分别召开第六届董事会第三十四次会议、2025 年度股东会，审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度预计的议案》，同意为纳入公司合并报表的子公司的融资提供连带责任保证，担保额度预计不超过人民币 826,000 万元，其中公司拟对资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为 747,500 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度为 78,500 万元。前述担保额度范围包括公司对相关全资及控股子公司的存量担保（即此前已与各银行签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的额度）、新增担保及存量担保的展期或续保，期限自股东会批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网上的《关于为子公司融资提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-30）。

2、近日，公司作为保证人分别与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行签署了《最高额保证合同》，与交通银行股份有限公司深圳分行签署了《保证合同》，为深圳市威线科电子有限公司（以下简称“深圳威线科”）、深圳市梦启半导体装备有限公司（以下简称“梦启半导体”）的融资贷款提供连带责任保证担保。具体担保情况如下表：

序号	保证人	被担保人	债权人	本次担保债权本金金额 （万元）
1	长盈精密	深圳威线科	中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	510
2	长盈精密	深圳威线科	交通银行股份有限公司深圳分行	510
3	长盈精密	梦启半导体	中国银行股份有限公司深圳南头支行	420

上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需另行召开董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 深圳市威线科电子有限公司

- 1、成立时间：2000年01月24日
- 2、住所：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区罗昌路88号厂房501
- 3、法定代表人：陈杭
- 4、注册资本：1,137.00万元

5、经营范围：一般经营项目：生产电脑连接线；电子产品的销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目：电子元器件制造；电子专用材料制造；汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

6、股权结构：公司直接持有深圳威线科51%股权，陈蜀江持有深圳威线科34%股权，深圳市融艺创新科技有限公司持有深圳威线科12%股权，刘爱生持有深圳威线科3%股权。

7、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目名称	2026年6月30日	2025年12月31日
资产总额	9,598.44	8,917.33
负债总额	10,772.46	9,207.13
其中：银行贷款总额	2,053.68	5,055.74
流动负债总额	10,012.84	9,207.13
净资产	-1,174.02	-289.80
	2026年1月至6月	2025年1月至12月
营业收入	7,809.26	9,094.17
利润总额	-783.38	-2,521.51
净利润	-783.38	-2,538.09

(二) 深圳市梦启半导体装备有限公司

- 1、成立时间：2021年02月04 日
- 2、住所：深圳市光明区公明街道上村社区元山工业区B区第34栋201
- 3、法定代表人：徐达海

4、注册资本：5,000.00万元

5、经营范围：提供集成电路、半导体器件和半导体设备的维修维护、技术服务和技术咨询，从事上述产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）研发、生产、销售、租赁半导体设备、耗材、半导体及电子元器件、电子产品、电器、仪器仪表；集成电路和半导体器件加工制造、测试服务。

6、股权结构：公司直接持有梦启半导体60%股权，剩余40%股权由深圳方达半导体装备有限公司持有，该公司的主要股东为胡敬祥，对其持股67.25%。

7、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目名称	2026年6月30日	2025年12月31日
资产总额	8,439.59	8,154.05
负债总额	9,957.62	8,892.96
其中：银行贷款总额	1,391.19	1,451.36
流动负债总额	9,869.95	8,722.44
净资产	-1,518.03	-738.91
	2026年1月至6月	2025年1月至12月
营业收入	486.18	1,576.99
利润总额	-779.12	-1,628.57
净利润	-779.12	-1,628.57

三、保证合同或担保文件的主要内容

（一）被担保人：深圳市威线科电子有限公司

- 1、债权人：中国工商银行股份有限公司深圳福永支行
- 2、保证人：深圳市长盈精密技术股份有限公司
- 3、债务人：深圳市威线科电子有限公司
- 4、担保最高本金限额：人民币510万元
- 5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：包括主债权本金（包括金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、

律师费等)。

7、保证期间：若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年。若主合同为开立担保协议，则保证期间为自债权人履行担保义务之次日起三年。若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起三年。若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

(二) 被担保人：深圳市威线科电子有限公司

- 1、债权人：交通银行股份有限公司深圳分行
- 2、保证人：深圳市长盈精密技术股份有限公司
- 3、债务人：深圳市威线科电子有限公司
- 4、担保最高本金限额：人民币510万元
- 5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

7、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。债权人与债务人约定债务可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

(三) 被担保人：深圳市梦启半导体装备有限公司

- 1、债权人：中国银行股份有限公司深圳南头支行

2、保证人：深圳市长盈精密技术股份有限公司

3、债务人：深圳市梦启半导体装备有限公司

4、担保最高本金限额：人民币420万元

5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：被确定属于本合同之被担保主债权的，基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

7、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年，在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并发分别要求保证人承担保证责任。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 9 月 21 日，公司及子公司累计的实际对外担保余额为人民币 267,488.88 万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益 834,556.44 万元的比例为 32.05%。

截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行签署的《最高额保证合同》，与交通银行股份有限公司深圳分行签署的《保证合同》；

2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月三十日